



TIF™ 100-30 是一种软硅凝胶间隙填充垫。这硅凝胶混合了填料，加上独特配方，使其拥有良好导热性能，亦保留了其极软的特性。因为**TIF™ 100-30**比一般的导热硅油的粘度为高，它能防止黏合物與填料分离的現象。另外它的粘合线偏移也比传统的散热垫控制得好。**TIF™ 100-30**的使用方法跟散热脂类似，可使用商业上一些方法包括丝印网印刷，注射或自动化设备操作。**TIF™ 100-30**的应用包括倒装芯片微处理器，PPGAs，微型BGA封装，BGA封装，DSP晶片，圆形加速晶片，LED照明和其他高功率的电子元件。

特性

- 》良好的热传导率: 3.0 W/mK
- 》柔软,与器件之间几乎无压力
- 》可轻松用於点胶系统生产

应用

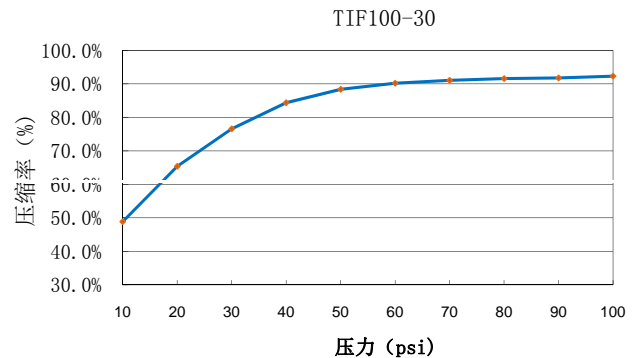
- 》散热器底部或框架
- 》LED液晶显示屏背光管 · LED电视LED 灯具
- 》高速硬盘驱动器
- 》微型热管散热器》汽车发动机控制装置
- 》通讯硬件》半导体自动试验设备

TIF100-30 系列特性表					
颜色	橘色	Visual	击穿电压(T= 1mm 以上)	>8000 VAC@1mmT	ASTM D149
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****	介电常数	5.5 MHz	ASTM D150
导热率	3.0 W/mK	ASTM D5470	体积电阻率	7.8X10 ¹³ Ohm-cm	ASTM D257
防火等级	94V0	E331100	使用温度范围	-20-200 °C	*****
比重	3.18 g/cc	ASTM D297	总质量损失 (TML)	0.55%	ASTM E595

TIF100 - 30

产品型号

导热率: 3.0 W/mk



罐装:

- 可在75毫升, 180毫升, 360毫升和600毫升的胶盒
 - 可在20公斤桶
- 如需不同罐装請与本公司联系。

如果您想了解更多导热材料的产品信息 · 请访问我司官网: <http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热矽胶片 | 陶瓷散热片 | 石墨片 | 导热塑料

加拿大:
Tel: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

台湾:
Tel: +886-2-22771007
Fax: +886-2-22771075
E-mail: jerry@ziitek.com.tw

东莞:
Tel: +86-769-38801208
Fax: +86-769-83791290
E-mail: angus@ziitek.com

昆山:
Tel: +86-512-57816297
Fax: +86-512-57816327
E-mail: kelvin@ziitek.com

成都:
Tel: +86-28-62379168
Fax: +86-28-62379168
E-mail: david_cd@ziitek.com